



L C I E

# Bulletins

Novembre 2005

## Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques Nouvelle liste des exemptions en application de la Directive RoHS

Deux nouvelles décisions de la Commission Européenne du 13 Octobre 2005 et du 21 Octobre 2005 relatives aux exemptions accordées dans le cadre de la directive européenne 2002/95/CE (directive RoHS), viennent d'être publiées dans le Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE L 271 du 15 Octobre 2005, 2005/717/CE et JOUE L 280 du 25 Octobre 2005, 2005/747/CE).

Pour rappel, à partir du 1<sup>er</sup> Juillet 2006, conformément aux exigences de la directive européenne RoHS, les producteurs (fabricants, importateurs ou distributeurs vendant sous leur propre marque) mettant sur le marché européen des équipements électriques et électroniques doivent s'assurer qu'ils ne contiennent pas certaines quantités des substances dangereuses suivantes au delà de valeurs limites de concentrations autorisées : plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, polybiphényles (PBB) et polybromophényl'éthers (PBDE).

Ces exemptions accordées pour certains matériaux et composants des équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir les six substances dangereuses, viennent modifier et compléter la liste initiale des exemptions spécifiées dans l'annexe de la directive européenne RoHS :

Substances dangereuses (R=remplacement et A=addition)	Source
1. Le mercure dans les lampes fluorescentes compactes ne dépassant pas 5 mg par lampe.	Directive 2002/95/CE
2. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques à usage général ne dépassant pas: — halophosphate 10 mg — triphosphate à durée de vie normale 5 mg — triphosphate à durée de vie longue 8 mg	Directive 2002/95/CE
3. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques pour usages spéciaux.	Directive 2002/95/CE
4. Le mercure dans les autres lampes non spécifiées dans la présente annexe.	Directive 2002/95/CE
5. Le plomb dans le verre des tubes cathodiques, des composants électroniques et des tubes fluorescents.	Directive 2002/95/CE
6. Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids, dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids et dans les alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids.	Directive 2002/95/CE
7. (R) — Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % en poids de plomb), — le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et de matrices de stockage, les équipements d'infrastructure de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission ainsi qu'à la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunications, — le plomb dans les composants électroniques en céramique (par exemple, les dispositifs piézo-électriques).	Décision 2005/747/CE
8. (R) Le cadmium et ses composés dans les contacts électriques et pour le cadmiage, sauf dans les applications interdites par la directive 91/338/CEE (*) portant modification de la directive 76/769/CEE (**) relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.	Décision 2005/747/CE
9. Le chrome hexavalent comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption.	Directive 2002/95/CE
9 bis. (A) Le décaBDE dans les applications polymérisées.	Décision 2005/717/CE
9 ter. (A) Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets en plomb/bronze.	Décision 2005/717/CE
11. (A) Le plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes.	Décision 2005/747/CE
12. (A) Le plomb en tant que matériau de revêtement pour l'anneau en C du module thermoconducteur.	Décision 2005/747/CE
13. (A) Le plomb et le cadmium dans le verre d'optique et le verre filtrant.	Décision 2005/747/CE
14. (A) Le plomb dans les soudures comportant plus de deux éléments pour la connexion entre les broches et le boîtier de microprocesseurs, à teneur en plomb comprise entre 80 et 85 % en poids.	Décision 2005/747/CE
15. (A) Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semiconducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée.	Décision 2005/747/CE

## Vos contacts

Valentine MENUET  
Chargée de clientèle  
01 40 95 63 57  
valentine.menuet@lcie.fr

Hélène MENOUE  
Chef de projet  
01 40 95 60 44  
helene.menou@lcie.fr

Paule PRIMET  
Veille Réglementaire  
01 40 95 61 59  
paule.primet@lcie.fr

### Le LCIE, laboratoire tierce partie

Votre partenaire pour les prestations d'essais et d'expertises réalisées dans le cadre de la directive européenne RoHS, vous tient informé de toutes les futures évolutions concernant les exigences réglementaires relatives à cette directive.